

证券代码：300708

证券简称：聚灿光电

公告编号：2026-017

## 聚灿光电科技股份有限公司 关于调整募集资金投资项目内部投资结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

聚灿光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 20 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投资项目”）实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的内部投资结构。现将具体情况公告如下：

### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意聚灿光电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕143 号）同意，聚灿光电向特定对象发行人民币普通股（A 股）118,000,000 股，每股发行价格为 9.20 元，募集资金总额 1,085,600,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额 1,081,550,174.72 元。上述募集资金已于 2023 年 8 月 15 日划转至公司为本次发行所开立的募集资金专项存储账户中，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 15 日出具了容诚验字[2023]215Z0042 号《验资报告》。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

### 二、募集资金投资项目情况

根据公司《创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书》以及《关于变更部

分募集资金用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2024-028）的相关内容，本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金金额	截至 2026 年 1 月 31 日实际投入募集资金金额	募集资金使用进度
Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目	155,000.00	28,155.02	23,227.72	82.50%
年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目	105,000.00	80,000.00	65,116.79	81.40%
<b>合计</b>	<b>260,000.00</b>	<b>108,155.02</b>	<b>88,344.50</b>	<b>81.68%</b>

注：公司于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十二次会议，2024 年 3 月 21 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》，同意公司调整募集资金投资项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”的部分募集资金（共计 80,000.00 万元）用途，用于新项目“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的实施。

### 三、调整募集资金投资项目内部投资结构的情况及原因

#### （一）调整募投项目内部投资结构的原因

为满足业务发展，充分考虑投资成本及效益等因素，公司重新评估了募投项目实际情况，相应调整了项目的内部投资结构。

在“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”建设过程中，为尽量利用公司现有场地、设备资源以及各业务之间的协同作用，原设计的宿迁厂房不再实施，通过优化宿迁现有厂区空间来承载项目建设内容。故调减该项目投资结构中“工程建设”费用。

在“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”建设过程中，原计划的工程建设及其他费用金额已无法满足实际需要，同时公司在工艺设备方面通过工艺流程更新及设备自动化装配升级，节约了部分设备采购成本，设备购置金额较计划减少。故相应调整该项目投资结构，主要是调增“工程建设及其他费用”，调减“设备购置”费用。

#### （二）调整募投项目内部投资结构的具体情况

## 1、“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”调整情况

单位：万元

序号	项目	项目总投资额 (调整前)	项目总投资额 (调整后)	项目总投资拟调 整金额
1	设备购置	107,334.59	107,334.59	-
2	工程建设	45,911.21	24,911.21	-21,000.00
3	预备费用	754.20	754.20	-
4	铺底流动资金	1,000.00	1,000.00	-
合计		<b>155,000.00</b>	<b>134,000.00</b>	<b>-21,000.00</b>

## 2、“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”调整情况

单位：万元

序号	项目	项目总投资额 (调整前)	项目总投资额 (调整后)	项目总投资拟调 整金额
1	设备购置	79,894.00	62,123.20	-17,770.80
2	工程建设及其他费用	16,229.20	34,000.00	17,770.80
3	预备费用	876.80	876.80	-
4	流动资金	8,000.00	8,000.00	-
合计		<b>105,000.00</b>	<b>105,000.00</b>	-

## 四、调整募集资金投资项目内部投资结构对公司的影响

本次募投项目调整内部投资结构是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，是对募投项目建设进行的合理调度和科学安排。本次调整并未改变项目实施主体和实施方式，不会对已有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

## 五、审议程序及相关意见

### (一) 审计委员会意见

公司召开第四届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》。经审议，审计委员会认为：公司本次调整“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的内部投资结构，符合《上市公司募集资金监管规则》《公司章程》《募集资金

管理制度》等相关规定，有利于推动公司战略落地和长远发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

（二）董事会意见

公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及募集资金投资总额不变的情况下，调整募投项目“Mini/Micro LED 芯片研发及制造扩建项目”“年产 240 万片红黄光外延片、芯片项目”的内部投资结构。

特此公告。

聚灿光电科技股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十日